

厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”、“公司”）接到通知，公司已签订以下 2 项担保的合同：

1、公司已与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为全资子公司厦门信达半导体科技有限公司（以下简称“信达半导体”）向交通银行股份有限公司厦门分行申请 1,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。

2、公司已与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为全资子公司厦门信达物联科技有限公司（以下简称“信达物联”）向交通银行股份有限公司厦门分行申请 1,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 1 月 4 日召开的二〇二一年第一次临时股东大会审议通过公司为全资及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案。

本次担保提供后，公司对前述 2 家全资子公司的担保情况如下：

2021 年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

被担保方	为资产负债率高于 70%的全资子公司提供担保额度	资产负债率高于 70%的全资子公司尚在担保期限内的担保余额	剩余 2021 年度内资产负债率高于 70%的全资子公司可用担保额度
信达半导体	人民币 350,000 万元 + 美元 69,800 万元	人民币 114,300 万元	人民币 235,700 万元 + 美元 69,800 万元
被担保方	为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度	资产负债率低于 70%的全资子公司尚在担保期限内的担保余额	剩余 2021 年度内资产负债率低于 70%的全资子公司可用担保额度
信达物联	人民币 350,000 万元	人民币 59,004.80 万元	人民币 290,995.20 万元

注：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

二、被担保人基本情况

1、厦门信达半导体科技有限公司

成立时间：2019年4月29日

注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路12号

法定代表人：高新颜

注册资本：8,000万元人民币

主营业务：半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；其他电子设备制造。

股东及持股比例：公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司持有该公司100%股权。

截至2020年12月31日（经审计），公司资产总额22,422.51万元，负债总额18,670.70万元，净资产3,751.81万元；2020年度，营业收入12,455.23万元，利润总额-3,040.88万元，净利润-3,040.88万元。截至2021年6月30日（未经审计），公司资产总额23,168.07万元，负债总额19,833.01万元，净资产3,335.07万元；2021年1-6月，营业收入9,031.30万元，利润总额-416.75万元，净利润-416.75万元。信达半导体不是失信被执行人。

2、厦门信达物联科技有限公司

成立时间：2005年12月22日

注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路14号

法定代表人：高新颜

注册资本：30,000万元人民币

主营业务：物联信息系统研发；研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬

件；计算机系统集成；研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统、电子标签及其周边设备、软件产品等。

股东及持股比例：公司全资子公司厦门信达信息科技集团有限公司持有该公司 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），公司资产总额 61,284.36 万元，负债总额 30,938.20 万元，净资产 30,346.16 万元；2020 年度，营业收入 28,170.03 万元，利润总额 748.37 万元，净利润 833.72 万元。截至 2021 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额 63,558.52 万元，负债总额 31,951.49 万元，净资产 31,607.03 万元；2021 年 1-6 月，营业收入 16,790.84 万元，利润总额 1,562.65 万元，净利润 1,260.87 万元。信达物联不是失信被执行人。

三、合同主要内容

担保方	被担保方	对手方名称	担保金额	担保范围	期限	担保方式
厦门信达	信达半导体	交通银行股份有限公司厦门分行	1,000 万元	1,000 万元融资额度	1 年	连带责任担保
厦门信达	信达物联	交通银行股份有限公司厦门分行	1,000 万元	1,000 万元融资额度	1 年	连带责任担保

四、反担保情况

信达半导体及信达物联系公司全资子公司，未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司 2021 年度经审议对全资及控股子公司担保额度为人民币 1,050,000 万元+美元 69,800 万元。其中，2021 年度新签署的担保金额合计为人民币 219,304.80 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 102.01%，剩余可用担保额度为人民币 830,695.20 万元+美元 69,800 万元。

截至公告日，公司实际对外担保总余额为人民币 371,404.80 万元+美元 7,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 195.26%。

上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至公告日，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二一年九月十八日